

特点:

- 频率范围: 0.6~1.8GHz
- 高增益: 35dB
- 低噪声: 0.8dB
- 高输出-1dB 压缩点: 17dBm
- 工作温度: -55~+85℃
- 封装尺寸: 4.0×4.0×1.5 (MAX)mm
- 产品执行标准为 GJB8481-2015


性能参数: (TA=+25℃, 50Ω系统)

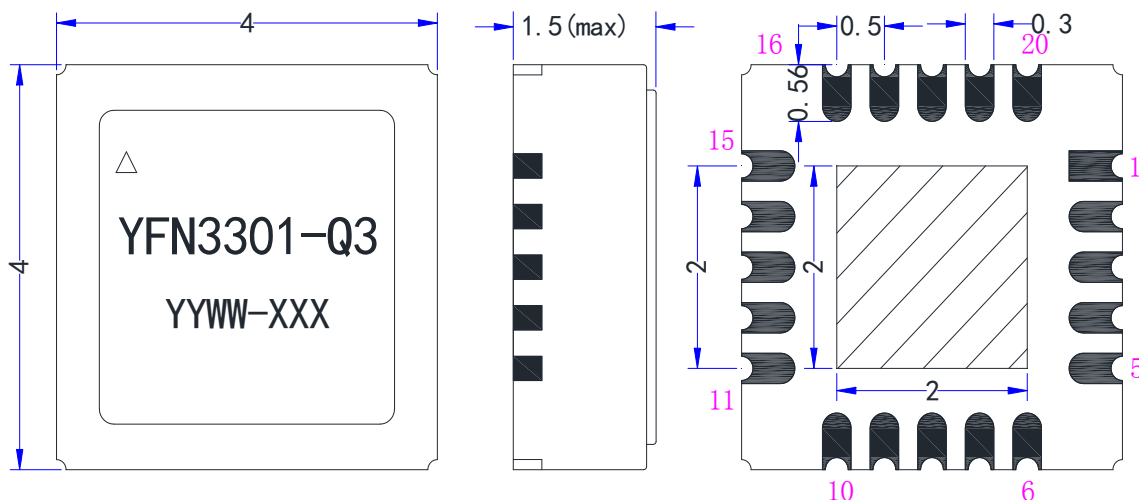
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注	
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	f=0.6~1.8GHz Vcc=+5.0V P _{in} =-30dBm	0.6		1.8	GHz		
增益	G		35	36	37	dB		
增益平坦度	ΔG			1.5	2	dB		
输入驻波	VSWR _i			1.6	2.0			
输出驻波	VSWR _o			1.3	2.0			
噪声系数	NF			0.8	1.2	dB		
输出 P ₋₁	P ₋₁			17	18	dBm		
反向隔离度	IR			35	40	dB		
电流	I				65	100	mA	
重量	m					1	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	+6	V	输入功率	+18	dBm
存储温度	-55~+125	℃			

封装外形图:

单位: mm 公差: ±0.1mm



字符标志:

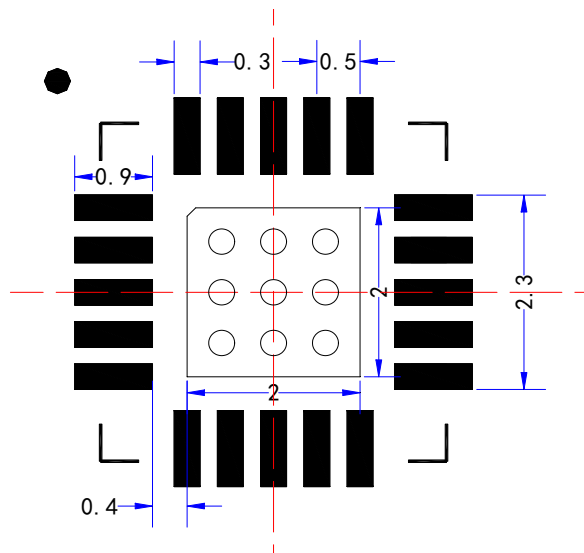
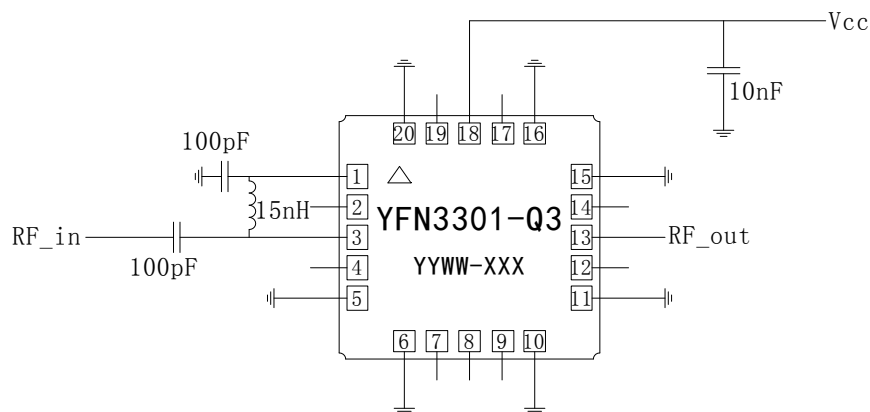
YFN3301-Q3	产品型号
△	1脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

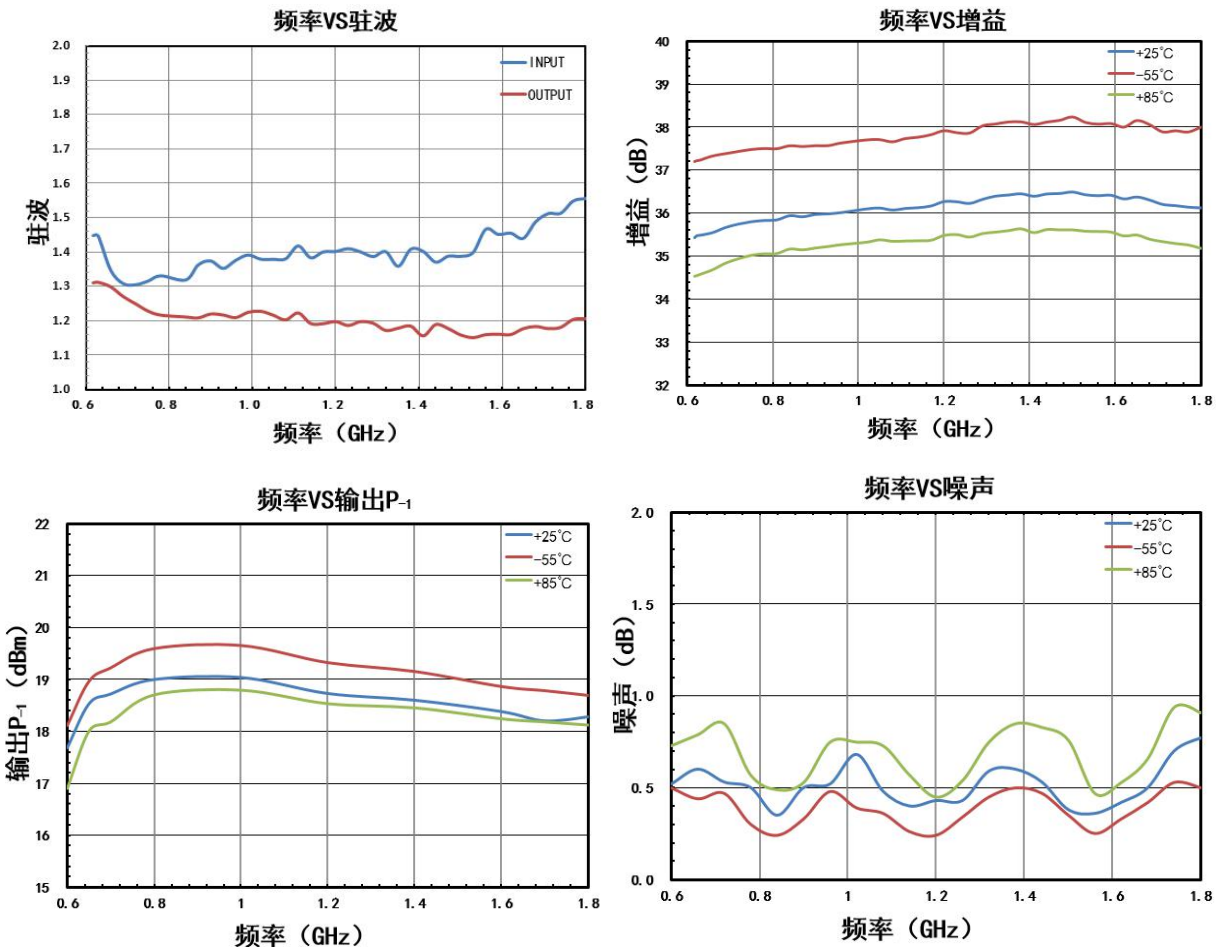
引脚	定义	定义
1	RM	匹配
3	RF_in	射频输入端
13	RF_out	射频输出端
18	Vcc	+5V 电源端
5/6/10/11/15/16/20	GND	接地端
2/4/7/8/9/12/14/17/19	NC	悬空

推荐焊盘图:

单位: mm 公差: ±0.1mm

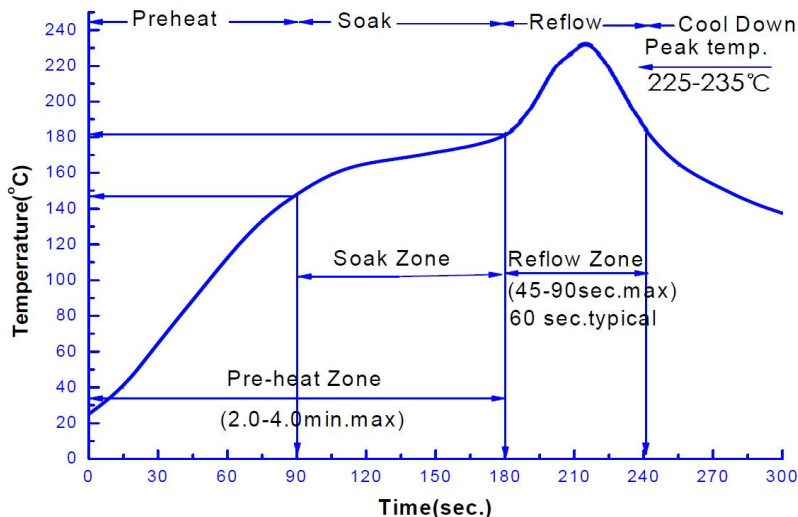

推荐电路:


典型测试曲线:



产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，耐静电能力 $\leq 250V$ ，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域），为了保证连接良好，底部引脚焊好之后，需对侧面引脚进行补焊；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183°C 回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 235℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。